

2.4.9 焼鈍軟化特性

2.4.9.1 試験条件

- 試験方法 : JCBA T315 ; 2001(仮) (銅および銅合金板条の焼鈍軟化特性試験方法) および JISZ 2241/JISZ 2201 に準拠
- 焼鈍温度 : 室温, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 および 600 × 60min
C1020 は室温, 100, 150, 175, 200, 250 および 300 × 60min
- 引張試験片 : JIS 5 号試験片, n=3
- 試験片採取方向 : 圧延方向に平行(L.D.)および直角(T.D.)
- 測定項目 : 引張強さ, 0.2%耐力, 伸び, 結晶粒度および硬さ

2.4.9.2 試験材料

合金番号と質別を表 9.1 に示す。

表 9.1 試験材料の合金番号と質別

合金番号 \ 質別	1/2H	H	EH
C1020	○	○	○
C2600	○	○	○
C5191	○	○	○
C5210	○	○	○

注: ○印は対象試験材料